

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2021-070

## 深圳同兴达科技股份有限公司 关于签订项目合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1、本《项目合作框架协议》为意向性协议，所涉事项须经双方协议确定的原则后，根据相关规定另行签署正式协议或合同。

2、因本协议项下的具体合作项目实施合同尚未签订，本协议的签订暂不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与日月光半导体（昆山）有限公司（以下简称“昆山日月光”）在深圳签订了《项目合作框架协议》，按照项目总投资金额，双方分别出资，合作“芯片金凸块（Gold Bump）全流程封装测试项目”。具体投资金额及各自出资金额比例以双方后续实际合作及项目进度情况为准。具体情况如下：

### 一、协议的基本情况

#### （一）协议签订的基本情况

基于公司长期专注电子配件制造业，对智能制造工厂管理系统和平台有积累较好的经验，昆山日月光深耕半导体封装测试行业多年，具有丰富、成熟经验与技术团队。双方充分发挥各自优势，为实现互利、共赢，双方分别出资，合作“芯片金凸块（Gold Bump）全流程封装测试项目”。

日月光投资控股股份有限公司（以下简称“日月光集团”）为客户提供半导体封装、测试、电子代工制造服务，在 2003 年已成为全球最大的半导体集成电路封装测试服务公司，并持续十多年保持同行业龙头位置。在全球封装测试产业中，拥有最完整的供应链系统，昆山日月光为日月光集团下属子公司。本次公司与日月光团队达成项目合作，有助于公司向产业链前端领域延伸布局，开阔新的业绩增长点，从而提高公司综合竞争力，提升经营效益与盈利水平。

本《项目合作框架协议》为公司日常经营合同，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司股东大会审议。

## （二）协议对方的基本情况

1、公司名称：日月光半导体（昆山）有限公司

2、法定代表人：徐世康

3、经营范围：生产高密度印刷电路板（BGA 基板）及光电子器件等新型电子元器件。半导体（硅片及化合物半导体）集成电路元器件及分离式元器件（包含闸流体、两端子闸流体、三端子闸流体等电子产品，光敏装置除外）的封装及测试，封装型式的设计开发，测试程序的设计开发，提供晶圆针测，可靠性测试服务（国家限制类及禁止类项目除外）。生产供输送或包装集成电路产品之塑料盘。生产其它集成电路及微电子组件零件（晶体管、二极管用引线丁架，集成电路用引线丁架）。销售自产产品，并提供相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、设立时间：2004 年 8 月 16 日

5、注册地址：江苏省昆山市千灯镇黄浦江路东侧中央大道北侧。

6、日月光半导体（昆山）有限公司与公司不存在关联关系，不构成关联交易，且本次交易为双方首次合作。

7、履约能力分析：日月光经营状况、财务状况和资信情况良好，具有良好的信用和较强的履约能力。

## 二、签订协议需履行的审议决策程序

本协议的签署已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。双方在涉及到

后续具体合作事宜，将就具体事项另行商洽签订协议，公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行相应的决策和审批程序。

### 三、协议的主要内容

#### （一）签约主体

甲方：深圳同兴达科技股份有限公司

乙方：日月光半导体（昆山）有限公司

#### （二）合作原则

1、合作双方在推进合作过程中，必须遵守国家的各项法律、法规和政策，符合国家产业发展导向及产业政策。

2、合作双方遵循“合作、发展、效率”宗旨，通过双方的努力，实现战略合作的高效、优质、快速开展。

#### （三）合作目标

甲乙双方以项目合作模式共同打造“芯片金凸块（Gold Bump）全流程封装测试项目”，从而在中国大陆建立卓越先进的高端封装技术的 Gold Bump 封测公司。

#### （四）合作方式

公司成立子公司，与昆山日月光项目合作方式进行合作。

#### （五）合作内容

为实现合作目标，本协议项下双方合作的内容为 Gold Bump 全流程封装测试项目的建设和运营，项目一期将建成月产能 2 万片 12 寸全流程 Gold Bump（金凸块）生产工厂。

本合作内容仅为甲乙双方初步合作意向，具体合作内容及法律相关的权利义务以签订的正式合同为准。

#### （六）权利和义务

涉及合作项目的具体权利义务将在正式签订的合同中约定。

#### 四、协议对公司的影响

##### （一）进军新领域，增强公司综合实力

作为先进封装芯片下游直接应用厂商，公司深刻了解先进封装技术在显示驱动 IC 中的重要作用，并看好其长期发展前景。国内面板不断扩大产能，驱动芯片的需求量随之增长，封测项目投资着眼于为国内面板产业提供完整的驱动 IC 供应链，发展卓越先进的高端封装技术，提升同兴达未来综合竞争力。

##### （二）向产业上游延伸，加大与上游供应商合作深度

建设封测产线是公司向前端制造领域延伸。在目前的业务模式下，上游驱动 IC 设计公司多采用 Fabless 模式，将晶圆生产和封装测试等环节分别外包。公司与全球主流驱动 IC 设计公司长期建立良好的合作关系，建成封测产线后可承接上游驱动 IC 设计公司拿到晶圆后的封测订单，进一步加深与上游公司合作方式。

##### （三）封测项目与公司主营业务具有协同效应

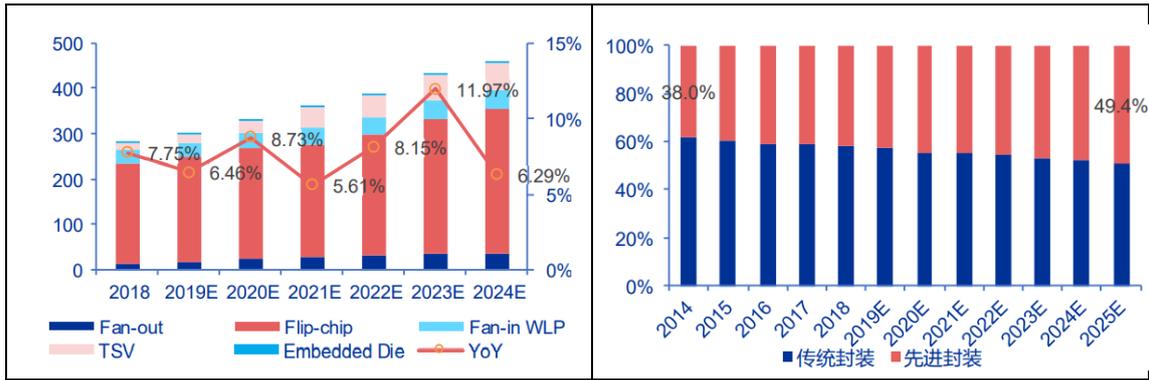
公司主营显示模组和光学摄像模组，原材料包括驱动 IC 和 CIS 芯片。封测项目可加强与上游芯片企业联系，一定程度保障模组业务的芯片供应，同时可降低部分采购成本，增强公司盈利能力。

#### 五、项目建设的可行性

##### （一）先进封测领域市场空间广阔，目前为最佳进入时机

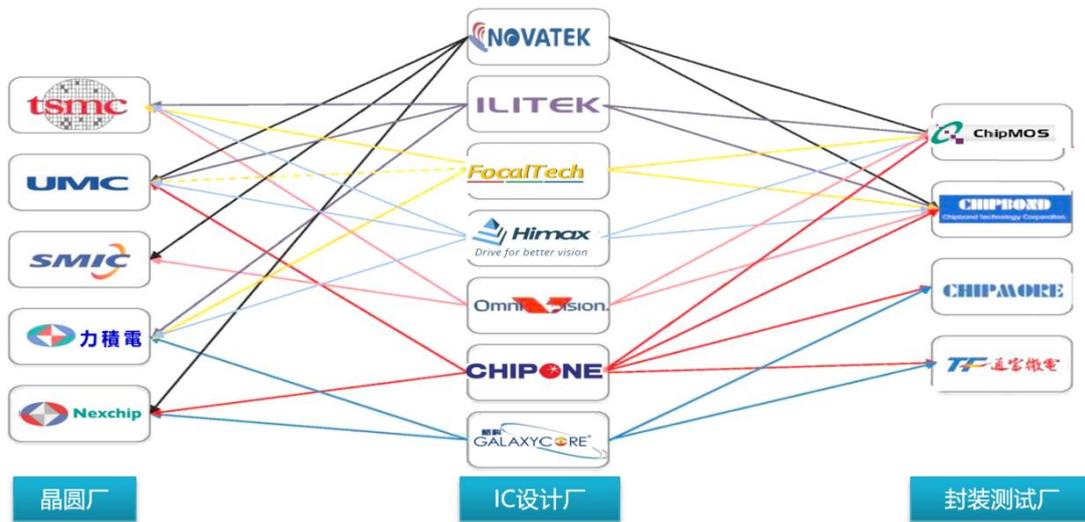
先进封装尤其是倒装芯片市场规模广阔。根据 Yole 预测，2025 年先进封装的占比将提升至整体封测行业的 49.4%，其中倒装为先进封装中最大市场。2018 年先进封装市场规模约为 280 亿美元，其中倒装市场规模约 224 亿美元，占比达 80%，2018-2024 年的 CAGR 为 6%。

全球先进封装技术市场规模（单位：亿美元）	先进封装与传统封装占整体封测行业比重
----------------------	--------------------



数据来源: Yole

中国大陆 Gold Bump 封测产能较少, 目前是进入此细分市场的最佳时机。全球芯片市场主要 IC 设计、晶圆代工、封测厂商如下图:



(二) 合作方日月光提供技术支持

先进封装金凸块生产过程涉及 UBM 镀膜和光刻等高难度工序, 不但需要根据产品制程特点购买配套设备, 并需要由专业团队进行调试和试产, 在此过程中特定设备需要持续运行和投入, 如果没有专业可靠的技术团队, 前期会耗费大量的时间与资源。本次项目选择日月光半导体负责技术与人员事项, 日月光在全球封测市场市占率长期位居第一, 具有丰富、成熟的技术和项目经验, 可最大程度保证快速量产和稳定产品良率。

(三) 公司显示模组业务为产品提供市场验证支持, 保障订单充足

芯片封测前期需要试产验证, 项目投产后, 公司可利用其驱动 IC 下游应用的市场优势, 协同封测厂进行制造工艺、技术参数的进一步调试, 争取在尽量短时间内完成验证并做量产。通过公司的批量采购和市场验证, 逐渐形成市场口碑,

有助于其他客户的开拓。

同时，公司长期与全球主流驱动 IC 设计厂商有大量采购驱动 IC 的业务往来，有较好的合作基础，满足要求的封测产线建成后有望拿到这些企业的大量订单。

最后本次投资资金为公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、风险提示

1、本战略合作协议系签约双方合作意愿的框架性、意向性、指导性文件，所涉事项将由协议各方根据协议确定的原则和相关规定另行签署正式协议或合同。

2、合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场开拓与波动、财务等方面可能存在的其他困难、不确定性或风险。

3、本次项目合作为公司首次进入新的业务领域，后续的合同执行及对公司的业绩的影响具有不确定性。

4、此次签订框架协议对公司当期业绩不存在重大影响情况。具体实施内容和进度公司会持续推进。

敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续的相关公告。

## 七、其他相关说明

1、公司最近三年不存在披露过框架性协议或意向性协议的情况。

2、公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股变动情况：

截至本公告披露日，公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高不存在持股变动情况，公司亦未收到未来三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高减持股份的通知。若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

## 八、备查文件

1、《项目合作框架协议》

特此公告

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2021年10月14日